



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100603001
2010 年 8 月 20 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HVAL-SLL (汎用リニアロジック) ULN2003A 製品 チップ一部改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、変更前の製品サンプル作製は行わない為、変更品評価用サンプルご入用の場合には、事前に本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。変更時期につきましては、次頁以降の変更時期をご参照下さい。お客様の受領連絡及びサンプル依頼は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)		☒ Final notice	
変更概要	☒ Design/Specification	☒ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling		☐ -
変更内容	HVAL-SLL (汎用リニアロジック) ULN2003A製品 チップ一部改定 現行： チップレビジョン Rev. C 変更後：チップレビジョン Rev. D			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	11 月下旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☐ 計画		☒ 終了	
製品表示	☐ 変更無し		☒ 変更あり	
備考	—			

変更内容

内容：弊社 HVAL-SLL (汎用リニアロジック) ULN2003A製品について、供給能力確保の為に、チップレビジョンを現行 Rev. CからRev. Dにチップを一部改訂し認定しました。これにより生産性が向上します。データシートの変更はありません。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

チップレビジョン

現行

Revision C

変更後

Revision D

理由：供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
ULN2003AD	ULN2003ADRG3	ULN2003ANS	ULN2003ANSRG4	ULN2003APWR
ULN2003ADE4	ULN2003ADRG4	ULN2003ANSE4	ULN2003APW	ULN2003APWRE4
ULN2003ADG4	ULN2003AN	ULN2003ANSRG4	ULN2003APWE4	ULN2003APWRG4
ULN2003ADR	ULN2003ANE3	ULN2003ANSR	ULN2003APWG3	
ULN2003ADRE4	ULN2003ANE4	ULN2003ANSRE4	ULN2003APWG4	

製品表示

この変更に伴い、チップレビジョン、出荷ラベル記載のチップレビジョンが下記のように変更されます。

	チップレビジョン (2P)
現行	C
変更後	D



図1 出荷ラベル記載箇所の例

信頼性試験

信頼性試験結果

信賴性試驗結果				
信賴性試驗期間	開始	—	終了	2010 年 8 月 12 日
信賴性試驗 — 試料構成詳細				
Qual Device:	ULN2003APW	Passivation:	10k A CN	
Wafer Fab Site:	SFAB	Wafer Process:	J11	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	TSSOP/PW/16	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4206193	
Bond Wire:	1.15 mils Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信賴性試驗結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**Steady-state Life Test	150C, 300 Hours		77/0	
Electrical Char.	Approved by Product Engr		Approved	
ESD HBM	2000V		3/0	
ESD MM	50V		3/0	
ESD CDM	500V		3/0	
Latch-up	per JESD78		6/0	
Manufacturability	Approved by A-T site		Approved	
X-ray	top side only		5/0	
Notes: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-1/260C				